

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2024-029

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案每股分红金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派发现金红利由0.62700元（含税）调整为0.62636元（含税）。

● 本次调整原因：因盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的股份登记手续已办理完成，新增股份446,154股，公司已发行股份总数由435,707,409股增加至436,153,563股。公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

一、调整前利润分配方案内容

公司于2024年2月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，于2024年6月18日召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。截至2023年12月31日，公司总股本为435,707,409股，拟以总股本为基准，拟每10股派发现金红利6.27元（含税），共计派发现金红利273,188,545.44元（含税），本次利润分配现金分红金额占2023年合并报表归属于母公司股东净利润的30%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在公司2023年年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

二、调整后利润分配方案

公司于2024年6月14日办理完成2019年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的股份登记手续，新增股份446,154股，公司已发行股份总数由435,707,409股增加至436,153,563股。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-027）。

依据上述总股本变动情况，公司按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，每股派发现金红利由0.62700元（含税）调整为0.62636元（含税）。具体计算方式如下：

1、调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷本次实际参与分配的股份数=273,188,545.44÷436,153,563≈0.62636元（含税，保留小数点后五位）。

2、实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股份数=0.62636×436,153,563≈273,189,145.72元（含税，保留小数点后两位，本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，本次利润分配每股现金红利为0.62636元（含税），利润分配总额为273,189,145.72元（含税），具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2024年6月25日